

TSMC, 18인치 웨이퍼 생산 본격화

공장부지 4만여평 1200억원에 매입 ... 2016년 시험가동 후 생산 돌입

세계 최대의 반도체 수탁 생산기업인 타이완 TSMC가 차세대 18인치 웨이퍼 생산을 위한 투자를 본격화하고 있다.

TSMC는 타이완 중북부 지역에 18인치 웨이퍼 생산공장 건설을 위한 토지 4만3000여평을 매입했다고 경제일보 등이 10월24일 보도했다.

매입금액은 32억타이완달러(약 1200억원)로 알려졌으며, TSMC는 2016년 18인치 웨이퍼공장 시험 가동에 들어가 이르면 2017년 말부터 생산에 나설 예정이다.

TSMC는 2015년까지 18인치 웨이퍼 양산 시스템을 구축할 계획이었으나 장비개발 지연 등으로 일정을 미룬 바 있다.

18인치 웨이퍼가 본격 생산되면 기존 12인치에 비해 2.5배의 반도체 칩을 얻을 수 있어 생산원가 부담이 줄어들 것으로 예상되고 있다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2012/10/25>